



HoLR2512 封体合金系列规格书

系列号	HoLR
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

规格书 Specification



制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoLR2512

适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR2512-75ppm 系列产品选型。

产品特点 Features:

合金芯片, 封体工艺, 焊接性能良好

高可靠性, 高过载能力, 产品精度高。

使用温度范围较宽无感型设计

电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 75ppm$

符合 ROHS 要求和无卤要求

产品名称 Product Name

封体合金电阻

产品型号 Product number

HoLR2512-2W-10mR-1%-75ppm

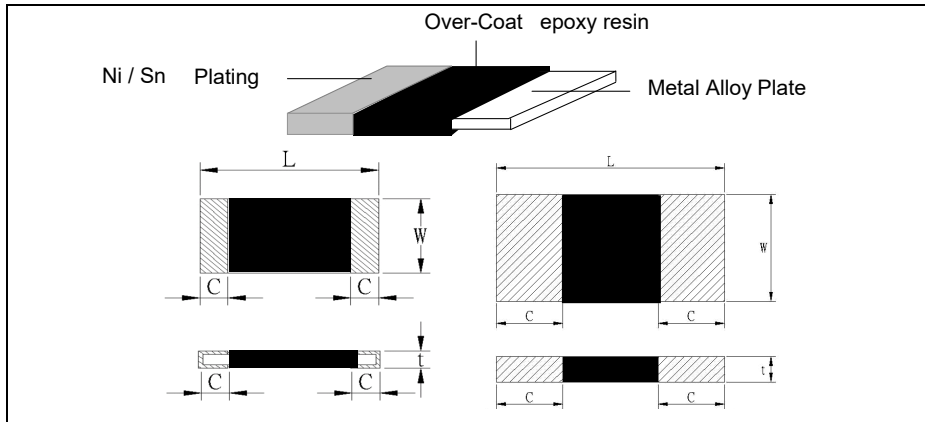
制造商	产品系列	封装	额定功率(W)	阻值(mR)	精度(%)	温度系数 TCR (ppm)
Ho 毫欧电子	LR 合金	2512	1W~3W	1mR~100mR	1%/5%	75
			1W~2W	100mR~500mR	1%/5%	75



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

系列号	HoLR
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

■ 产品结构及尺寸 Product structure and size



产品尺寸:

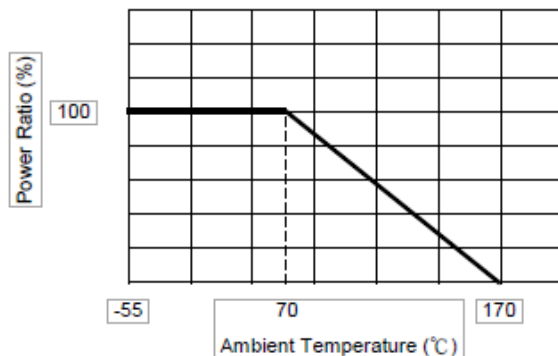
型号	阻值	L	W	C	T
HoLR2512	1mR~4mR	6.4±0.2	3.2±0.2	2±0.2	0.7±0.2
	5mR~500mR	6.4±0.2	3.2±0.2	0.9±0.2	0.7±0.2

■ 电气参数 Electrical parameter

额定功率 Rated power	1 mΩ ≤ R ≤ 100mΩ (1W、1.5 W、2 W、3W) 100 mΩ < R ≤ 500mΩ (1W、1.5W、2W)
阻值范围 Resistance range	1mR~500mR
最大额定电流 Max.Rated Current	1.41A~54.77A
准确度等级 AccuracyClass	1%、5%
电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤75
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55°C~+170°C

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 -55 ~+170 °C 电阻温度达到 70°C 时降功率示意图



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

系列号	HoLR
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

■ 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu

I :Rated Current (A)

P:Rated Power (W)

R:Resistance Value (Ω)

$$I = \sqrt{P/R}$$

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension

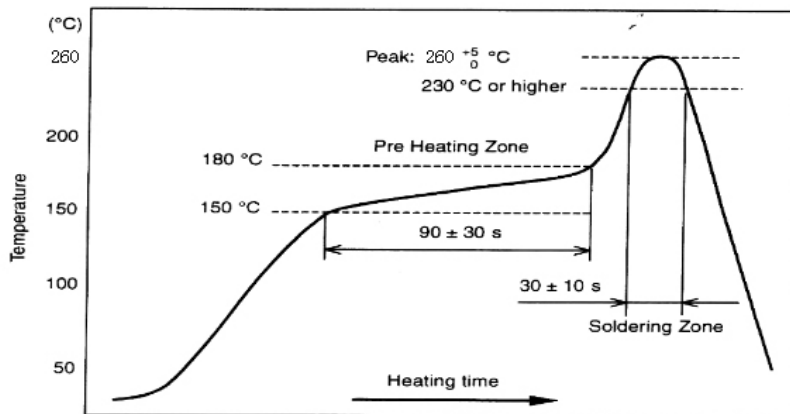


阻值	a	b	L
1mR~4 mR	4	3.1	1.3
5mR~500 mR	4	2.1	4.1

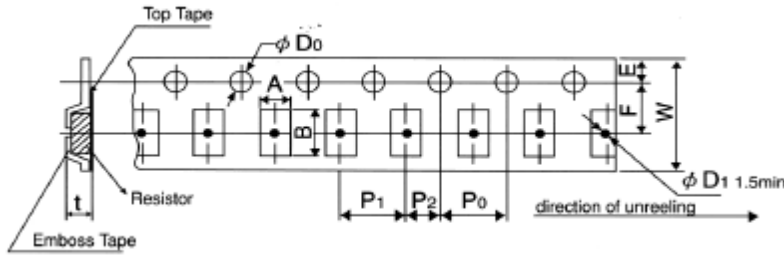
■ 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters

预热: 150 to 180 °C, 90±30秒, 焊接区: 230°C 或更高, 30±10 秒
峰值: 260±5°C, 5秒.

回流焊曲线图



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)


A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
3.6±0.2	6.9±0.2	12±0.2	5.5±0.05	1.75±0.1	4.0±0.1	2±0.05	4±0.05	Φ 1.5±0.1	1.2±0.15

■ 可靠性测试 Reliability Tests

Test Items	Reference standard	Condition of Test	Test Limits
Temperature Coefficient of Resistance	IEC60115-1 4.8 JIS C 5201-1 4.8	+25℃ ~ +125℃	Refer 4.0
Load Life	IEC60115-1 4.25.1 JIS C 5201-1 4.25.1	1000hours at rated power, 70℃, 1.5hours "ON", 0.5hour "OFF"	< ±1%
Short Time Overload	IEC60115-1 4.13 JIS C 5201-1 4.13	5 X rated power for 5s	< ±0.5%
Moisture no Load	IEC60115-1 4.24.2.1a) JIS C 5201-1 4.24.2.1a)	85℃, 85%RH, 1000hrs	< ±1%
Temperature cycle	IEC60115-1 4.19 JIS C 5201-1 4.19	-55℃ & +155℃, 300cycle, 15min per extreme condition	< ±0.5%
Resistance to Soldering Heat	IEC60115-1 4.18 JIS C 5201-1 4.18	260±5℃ for 20±1 sec	< ±0.5%
Solderability	IEC60115-1 4.17 JIS C 5201-1 4.17	245±5℃, 2±0.5sec	At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder
High Temperature Exposure	IEC60115-1 4.23.2 JIS C 5201-1 4.23.2	170℃, 1000hrs	< ±1%
Low Temperature Storage	IEC60115-1 4.23.4 JIS C 5201-1 4.23.4	-55℃, 1000hrs	< ±0.5%
Substrate Bending	IEC60115-1 4.33 JIS C 5201-1 4.33	Bending width 2mm	< ±1%
Insulation Resistance	IEC60115-1 4.6 JIS C 5201-1 4.6	100V DC for 1 minute	>100 MΩ

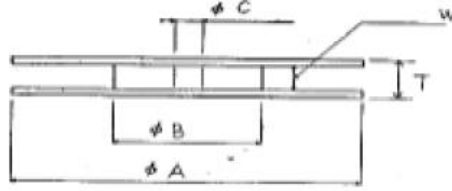
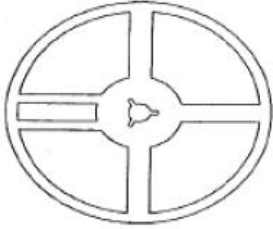
地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoLR2512 封体合金系列规格书

系列号	HoLR
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

■ 卷轴规格 Reel Specification



ΦA	ΦB	ΦC	W	T
180+0/-3	60±1	13±1	13±1	15.4±2

■ 包装方式 Packing

编带盘装：4000PCS/盘



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼